



社団法人溶接学会第72回通常総会並びに平成16年度春季全国大会開催通知

第72回通常総会並びに平成16年度春季全国大会を下記の通り開催いたします。

【第72回通常総会】

日 時：平成16年4月22日（木）10：00～11：30

場 所：（財）日本教育会館

議 題：平成15年度事業報告，平成15年度決算報告，
平成16年度事業計画案，平成16年度収支予算案

（ご注意）会場は虎ノ門の国立教育会館とは異なりますのでご注意ください。

【平成16年度春季全国大会】

期 日：平成16年4月21日（水），22日（木），23日（金）

場 所：（財）日本教育会館

東京都千代田区一ツ橋2-6-2

TEL 03-3230-2831 FAX 03-3230-2834

講演会プログラムは論文集（22巻1号）に掲載いたします。

全国大会参加費：

会 員 2,000円

非会員 4,000円

学生（会員，非会員とも）無料



春季全国大会講演概要(74集)の頒布について

下記要領により平成16年度春季全国大会講演概要集を頒布いたしますので、希望者は要領にしたがいお申込み下さい。

1. 頒 価：5,000円
2. 申込要領：①郵送の場合は、送料（500円程度）加算します。
②2冊以上まとめて郵送する場合は現品発送と同時に代金および郵便料金合計

金額を請求いたしますので折返しご納入下さい。この場合申込者名および送り先を明記した申込書（任意）によりお申込下さい。FAXでも結構です。

③直接購入の場合代金ご持参の上事務局までご来所下さい。また大会当日受付でも頒布いたします。

3. 頒布開始：平成16年3月15日頃から



Mate 2004 第10回「エレクトロニクスにおけるマイクロ接合・実装技術」

シンポジウム

《ブロードバンドインターネット時代に向けた生産技術革新とサイエンス》参加者募集

- 主 催：**(社) 溶接学会 マイクロ接合研究委員会
エレクトロニクス生産学会準備会
- 共 催：**(社) 機械学会 エレクトロニクス実装における
信頼性設計に関する研究分科会，(社) 高温学会
加工・再生研究情報委員会，(社) 日本塑性加工
学会 接合・複合分科会 レーザ加工学会，技術
研究組合 超先端電子技術開発機構 (ASET) 電
子SI技術研究部，IMS プロジェクト 環境対応
次世代接合技術の開発，大阪大学 先端科学技
術共同研究センター

開催趣旨：

日本のエレクトロニクス産業は、この20年間、高機能化、高信頼化、小型化、低コスト化の技術開発に支えられた新たな電子デバイス・部品を組み込んだ電子システム創成の下、日本の高度成長を牽引してきました。今後も日本が世界を先導し続けるには、生産技術を科学的に探求することはもちろんのこと、既存の学問領域、設計・生産技術などの領域を越えて、エレクトロニクスを取巻く科学技術、経営・生産システム、価値システム、などの広い範囲を取り込んだグローバ

ルなオプティマイゼーションが必要になってきています。本シンポジウムでは、これら生産技術に関する最新の研究・開発に関する研究者相互の情報交換の場をより広くかつ定期的に持ち、生産の科学と技術の進展を促すことを目的として企画開催されます。

日時：平成16年2月5日（木）8:50～17:40

平成16年2月6日（金）9:00～17:30

会場：パシフィコ横浜 会議センター

5階（小ホール，501，502）

横浜市西区みなとみらい1丁目1-1

TEL: 045-221-2121

シンポジウム参加登録費（論文集代を含む）

○主催・共催団体登録会社：20,000円

○溶接学会，協賛学協会会員会社：30,000円

○論文口頭発表者：15,000円

○大学・国公立研究機関：10,000円

○学生：5,000円

○その他（一般）：40,000円

シンポジウム参加申し込み方法

所定の用紙に必要事項（申込者氏名，連絡先住所，電話番号，FAX番号など）を記入し，次の申込先にお申し込み下さい。受付次第，参加受付書を返送させていただきます。参加登録料は，現金書留，郵便振替，銀行振込のいずれかでお支払い下さい。

問合せ，申込先：（社）溶接学会 Mate 2004 事務局
担当連絡先：

TEL：06-6879-8698，FAX：06-6878-3110

E-Mail：mate@jwri.osaka-u.ac.jp

参加申し込み締め切り日：平成16年1月20日（火）

振込先銀行：三井住友銀行 豊中支店

口座番号：普通 No.1962097

口座名義：Mate 組織委員会 渥美 幸一郎

シンポジウム URL：

<http://www.soc.nii.ac.jp/jws/research/micro/Mate2004.html>

プログラム（セッション名と発表件数）

2月5日（木）8:50～17:40（18:00～懇親会）

◆特別講演セッション

「生産技術革新とサイエンス」

○有機ELデバイスの現状と課題

○カーエレクトロニクスにおける生産技術動向

○本質を探る最先端の分析・解析技術

[A-1] フロー槽・鉄系材料の侵食 (4件)

[A-2] 機械的信頼性 (5件)

[A-3] ソルダ材料 (6件)

[B-1] 導電性樹脂接続 (4件)

[B-2] 微細接合 (5件)

[B-3] 接合技術 (6件)

[C-1] 基板 (4件)

[C-2] 基板・配線 (5件)

[C-3] レーザプロセッシング (6件)

2月6日（金）9:00～17:30

[A-4] 評価 (5件)

[A-5] ソルダリング (5件)

[A-6] Sn-Zn系Pbフリーソルダ (4件)

[A-7] Sn-Ag系Pbフリーソルダ (5件)

[B-4] 環境・リサイクル (4件)

[B-5] フリップチップボンディング (6件)

[B-6] パンプ (4件)

[B-7] BGA, CSP (5件)

[C-4] 薄膜・微細プロセス (5件)

[C-5] 開発I (5件)

[C-6] 開発II (5件)

（一般論文発表合計98件）



【新刊】のご案内「溶接冶金研究の進歩と今後の展望」

溶接学会技術資料（JWS Bulletin） No.15
溶接冶金研究の進歩と今後の展望

（社）溶接学会溶接冶金研究委員会編

これまで溶接冶金研究委員会では、溶接に伴う諸問題に対して、主として材料科学的な見地から検討し、メカニズムの解明と問題の解決を図るための討論の場として活動を続けてまいりました。その活動と研究状況の把握を目的に、1978年「溶接冶金（レビュー）上・下」を発刊し、溶接冶金現象や溶接欠陥及び特性の変化に関する集録を行いました。その後も溶接冶金に関する研究は質的量的にさらに大きく進歩を続けており、前回レビューから約25年を経た今、それらを新たに整理しまとめることが必要な時期となってまいりました。そこで、当研究委員会では、このたび新たなレビューとして溶接学会技術資料「溶接冶金研究の進歩と今後の展望」（ブリテン No.15）を完成致しました。

本書は溶接に携わる研究者や技術者の方々にとって、溶接冶金現象や溶接欠陥及び特性の変化に関する研究の現状を知る意味で好適な参考書であり、是非、座右の書に加えて頂くことをお願いする次第であります。

平成15年9月発行

価 格：10,000円／送料400円

3,000円／送料400円（学生）

体 裁：B5版（411ページ）

申込方法：購入ご希望の方は、電子メールまたはFAXにて下記宛にお申し込み下さい。

〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-11

（社）溶接学会 溶接冶金研究委員会ブリテン係

FAX：（03）3253-3059

TEL：（03）3253-0488

E-mail：jws-ym@kt.rim.or.jp